


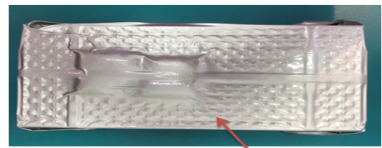


## 高云的产品变更通知 (GPCN)

### 概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了加强包装的防护。

### 描述

采用托盘包装的所有产品型号，包装时在托盘与铝箔袋之间增加一块防静电珍珠棉做防护。

<p>变更前</p>	<p>托盘与铝箔袋之间无珍珠棉，如下图：</p> <p>干燥剂 Desiccant (<math>\geq 1/2U</math>)      抽真空后热封 Heat seal after vacuum</p>   <p>湿度指示卡 Humidity indicating card      铝箔袋 Aluminum foil bag</p>
<p>变更后</p>	<p>托盘与铝箔袋之间增加一块防静电珍珠棉做防护，如下图：</p> <p>干燥剂 Desiccant (<math>\geq 1/2U</math>)    珍珠棉 EPE Foam    抽真空后热封 Heat seal after vacuum</p>   <p>湿度卡 Humidity Indicator Card      铝箔袋 Aluminum foil bag</p>

### 受影响的产品

采用托盘包装的所有产品型号。

### 关键日期

此次变更与 PCN 生效时间同步，自 2022 年 09 月 05 日开始执行，当前产品的 LTB 及 LTS 为 2022 年 09 月 04 日。

### 响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

### 附加文件

无

## 技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：[www.gowinsemi.com.cn](http://www.gowinsemi.com.cn)

邮箱：[support@gowinsemi.com](mailto:support@gowinsemi.com)

## 版本信息

日期	版本	说明
2022/07/20	1.0	初始版本。

**版权所有©2022 广东高云半导体科技股份有限公司**

**GOWIN高云**、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

### **免责声明**

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。